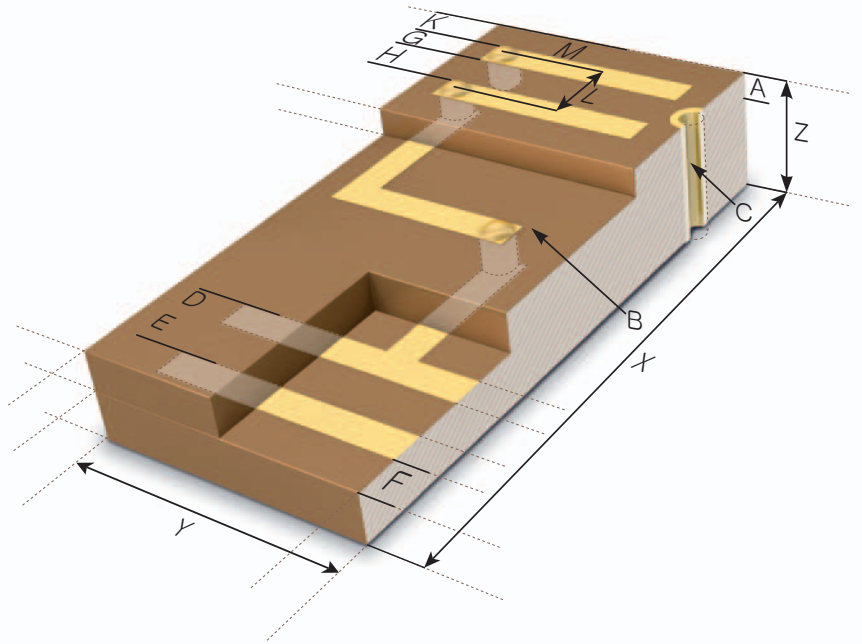


고온 동시소성 세라믹 (HTCC) 기판의 설계 규정

사용되는 패키지 (제품)

- 레이저 펌프
- MEMS 애플리케이션
- IR 센서



재료 데이터

	표시	표준	허용오차	특수	허용오차	
구조 파라미터	길이	X	5 - 25	± 1 % (as fired)	2 - 50	± 0.5 % (as fired)
	폭	Y	5 - 25	± 0.05% (machined)	2 - 50	± 0.03% (machined)
	기판 두께	Z	0.4 - 3	± 3 %	0.2 - 5	± 1.5 %
	층 두께	A	0.12, 0.2, 0.25 0.32, 0.4, 0.5	± 10 %	0.1	± 5 %
	평면도 (as fired)		0.08 / 10 mm		0.05 / 10 mm	
	평면도 (machined)		0.02 / 10 mm		0.005 / 10 mm	
수직 인터커넥트	Filled Via					
	일반 직경	B	0.18		0.1	
	직경 범위		0.15 - 0.3		0.1 - 0.5	
	Via-to-Via 센터라인	L	1			
	Via-to-Edge	M	두께 + via 직경			
	Bore Coated Via					
	일반 직경 (ID)	C	0.4			
직경 범위		0.4 - 0.8				
내부 금속회로	선 폭 (via 없는 경우)	D	0.08	± 20 %		
	선 간 공간 (via와의 거리)	E	0.08	± 20 %		
	선 폭 (via 있는 경우)		0.25	± 20 %		
	선 간 공간 (via 근처)		0.2	± 20 %		
	edge로부터의 공간	F	0.7		0.5	
표면 금속회로	선 폭 (via 없는 경우)	G	0.1	± 20 %		
	선 간 공간 (via와의 거리)	H	0.1	± 20 %		
	선 폭 (via 있는 경우)		0.3	± 20 %		
	선 간 공간 (via 근처)		0.25	± 20 %		
	edge로부터의 공간	K	0.4		0	

단위: mm, %

추가 정보 문의처:
쇼트 전자부품 패키징 사업부
광학 전자 부문
Christoph-DornerStresse 29
84028 Landshut
Germany

전화: +49 (0) 871/826-329
팩스: +49 (0) 3641/288-89090
Tanja.Wituschek@schott.com
www.schott.com/epackaging

SCHOTT
glass made of ideas